

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

A. Interconnect & Package 분과

Room G

국실 (본관, 5층)

2013년 2월 5일(화) 15:15-16:30

[TG3-A] Cu 배선 및 차세대 배선 기술

좌장: 손현철(연세대학교), 황태주(삼성전자)

[초청]

- | | | |
|---------|-------------|--|
| TG3-A-1 | 15:15-15:45 | Degradation of Organic Additives in Copper Electrodeposition
Jae Jeong Kim
School of Chemical and Biological Engineering, Seoul National University |
| TG3-A-2 | 15:45-16:00 | Moderate Temperature Growth of Carbon Nanotubes by Chemical Vapor Deposition with CBr₄ Feedstock
최태진, 김형준
연세대학교 전기전자공학부 |
| TG3-A-3 | 16:00-16:15 | A New Material for an Effective Diffusion Barrier with a Near Zero-Thickness in Copper Metallization
Juree Hong, Seulah Lee, Sanggeun Lee, Heetak Han, and Taeyoon Lee
School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University |
| TG3-A-4 | 16:15-16:30 | 반도체 배선으로서의 그래핀의 응용
강창구 ¹ , 임성관 ² , 이상철 ² , 이상경 ¹ , 조천흠 ² , 이영곤 ¹ , 황현준 ¹ , 김용훈 ¹ , 최호준 ¹ , 최선희 ¹ , 이병훈 ^{1,2}
¹ 광주과학기술원 신소재공학과,
² 광주과학기술원 나노바이오전자재료공학과 |